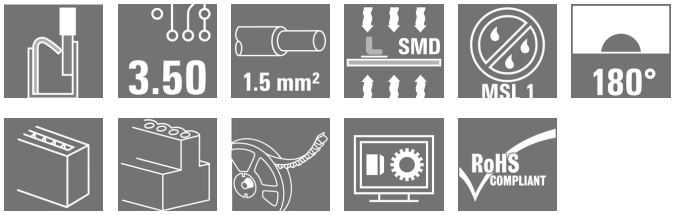
OMNIMATE Signal – serie LSF
LSF-SMD 3.50/12/180 SN BK RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Produktillustration



Avbildning liknande



Den innovativa snabbanslutningen – enkel, säker och ekonomisk:
Kretskortsplintar med fjäderanslutning och direktinstickstekniк (PUSH IN). En milstolpe inom anslutningstekniken.
Genialt enkelt konstruktion och användning:
• Anslut och lösgör enkelt massiva ledare eller ledare med ändhylsor, helt utan verktyg.
• Automatisk hantering i reflow- eller i ånglödning
• Potentialer och anslutningar entydigt markerade med färgade tryckknappar
Summa summarum: Design-In, bearbetning och användningsbredd i världsklass.
Kretskortsplint för helautomatiskt montage och reflowprocess (SMD), med PUSH IN-anslutningsteknik. Ledarinsättning och slidmanövrering från samma håll (TOP).
• Massiva & flertrådiga ledare med ändhylsor behöver bara skjutas in och är redo direkt.
• Vid anslutning av flertrådiga ledare utan ändhylsor används manöverknappen för att öppna anslutningen.
• Intuitiv hantering genom entydig märkning av ledarinföring och manöverknapp.
• Förpackning i Tape on Reel
• Ledarutgångsriktning i 180° utförande.

Allmänna beställningsdata

Typ	LSF-SMD 3.50/12/180 SN BK RL
Art.nr.	1250470000
Artikelbeteckning	Kretskortsplint, 3.50 mm, Antal poler: 12, 180°, svart, PUSH IN, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Tape
GTIN (EAN)	4050118041064
Frp	180 Stück
Produktparametrar	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² UL: 300 V / 12 A / AWG 24 - AWG 16
Förpackning	Tape

OMNIMATE Signal – serie LSF
LSF-SMD 3.50/12/180 SN BK RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	42,7 mm	Byggbredd (tum)	1,681 inch
Höjd	16,3 mm	Bygghöjd (tum)	0,642 inch
Höjd lägstbyggande	16,3 mm	Djup	10,5 mm
Byggdjup (tum)	0,413 inch	Nettovikt	8,48 g

Packaging

Förpackning	Tape	VPE-längd	50 mm
VPE-bredd	330 mm	VPE-höjd	330 mm
Tape depth (T2)	17,6 mm	Tape width (W)	56 mm
Tape pocket depth (K0)	17,1 mm	Tape pocket height (A0)	11,2 mm
Tape pocket width (B0)	43,7 mm	Tape pocket separation (P1)	20 mm
Tape hole separation (E)	1,75 mm	Tape pocket separation (F)	26,2 mm
Tape reel diameter ⌀ (A)	330 mm	Surface resistance	Rs = 10^9 - 10^{12} Ω
Bredd på Pick & Place-dyna (W_{PPP})	7,5 mm	Längd på Pick & Place-dyna (L_{PPP})	8,5 mm
Diameter på indragningsytan (ø $D_{max.}$)	9 mm		

Karakteristiska systemvärden

Produktfamilj	OMNIMATE Signal – serie LSF	Ledaranslutningsteknik	PUSH IN
Montering på kretskortet	SMD-lödanslutning	Ledarutgångsriktning	180°
Delning i mm (P)	3,5 mm	Delning i tum (P)	0,138 inch
Antal poler	12	Uppgraderbar av kunden	Nej
Samplanaritet:	100 µm	Antal lödstift per pol	2
Avisoleringslängd	8 mm	L1 i mm	38,5 mm
L1 i tum	1,518 inch	Beröringsskydd enligt DIN VDE 0470	IP 20
Beröringsskydd enligt DIN VDE 57	fingersäker	Genomgångsmotstånd (6)	1,60 mΩ

Materialdata

Isoleringsmaterial	LCP GF	Färgkod	svart
Färg manöverelement	vit	Material manöverelement	PPA GF
Färgtabell (jämförbar)	RAL 9011	Isoleringsmaterialgrupp	IIIa
CTI	≥ 175	Isolationshållfasthet	≥ 10^8 Ω
Moisture Level (MSL)	1	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Kontaktmaterial	Kopparlegering	Skiktstruktur för lödanslutningen	4-6 µm Sn matt
Lagertemperatur, min.	-25 °C	Lagertemperatur, max.	55 °C
relativ fuktighet vid lagring, max	80 %	Driftstemperatur, min.	-50 °C
Driftstemperatur, max	120 °C	Temperaturområde Montage, min.	-30 °C
Temperaturområde Montage, max.	120 °C		

Anslutningsbara ledare

Anslutningsområde, min.	0,13 mm²
Anslutningsområde, max.	1,5 mm²
Ledardiameter, AWG, min.	AWG 28
Ledardiameter, AWG, max	AWG 14
entrådig, min. H05(07) V-U	0,2 mm²
entrådig, max. H05(07) V-U	1,5 mm²
fintrådig, min. H05(07) V-K	0,2 mm²
fintrådig, max. H05(07) V-K	1,5 mm²
med AEH med krage DIN 46 228/4, min.	0,25 mm²

OMNIMATE Signal – serie LSF
LSF-SMD 3.50/12/180 SN BK RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

med ändhylsa med krage DIN 46 228/4, max.	0,75 mm²			
med ändhylsa enligt DIN 46 228/1, min.	0,25 mm²			
med ändhylsa enligt DIN 46 228/1, max.	1,5 mm²			
Anslutningsbar ledare	Ledarens anslutningsarea	Typ	fintrådig	
		nominell	0,25 mm²	
	AEH	Avisoleringslängd	nominell	10 mm
	Ledarens anslutningsarea	Typ	fintrådig	
		nominell	0,34 mm²	
	AEH	Avisoleringslängd	nominell	10 mm
	Ledarens anslutningsarea	Typ	fintrådig	
		nominell	0,5 mm²	
	AEH	Avisoleringslängd	nominell	10 mm
	Ledarens anslutningsarea	Typ	fintrådig	
		nominell	0,75 mm²	
	AEH	Avisoleringslängd	nominell	10 mm
	Ledarens anslutningsarea	Typ	fintrådig	
		nominell	1,5 mm²	
	AEH	Avisoleringslängd	nominell	7 mm
Max. anslutningsområde	1,5 mm²			

Märkdata enligt CSA

Institut (CSA)		Certifikat nr. (CSA)	200039-1664286
Märkspänning (användargrupp B / CSA)	300 V	Märkspänning (användargrupp D / CSA)	300 V
Märkström (användargrupp B / CSA)	10 A	Märkström (användargrupp D / CSA)	10 A
Ledardiameter AWG, min.	AWG 28	Ledardiameter AWG, max.	AWG 14
Hänvisning till godkännandevärden	Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg.		

Märkdata enligt UL 1059

Institut (cURus)		Certifikat nr (cURus)	E60693
Märkspänning (användargrupp B / UL 1059)	300 V	Märkspänning (användargrupp D / UL 1059)	300 V
Märkström (användargrupp B / UL 1059)	12 A	Märkström (användargrupp D / UL 1059)	10 A
Ledardiameter AWG, min.	AWG 24	Ledardiameter AWG, max.	AWG 16
Hänvisning till godkännandevärden	Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg.		

OMNIMATE Signal – serie LSF
LSF-SMD 3.50/12/180 SN BK RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Märkdata enligt IEC

testad enligt standard	IEC 60664-1, IEC 61984	Märkström, min. antal poler (Tu=20°C)	17,5 A
Märkström, max. antal poler (Tu=20°C)	16 A	Märkström, min. antal poler (Tu=40°C)	17,5 A
Märkström, max. antal poler (Tu=40°C)	14 A	Märkspänning vid överspänningsk./ Nedsmutsningsgrad II/2	320 V
Märkspänning vid överspänningsk./ Nedsmutsningsgrad III/2	160 V	Märkspänning vid överspänningskat./ Nedsmutsningsgrad III/3	160 V
Märkspänning vid överspänningsk./ Nedsmutsningsgrad II/2	2,5 kV	Märkspänning vid överspänningsk./ Nedsmutsningsgrad III/2	2,5 kV
Märkstötspänning vid överspänningsk./ Nedsmutsningsgrad III/3	2,5 kV	Korttidströmhållfasthet	3 x 1s mit 80 A

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001284	ETIM 4.0	EC002643
ETIM 5.0	EC002643	ETIM 6.0	EC002643
eClass 6.2	27-26-11-01	eClass 7.1	27-44-04-01
eClass 8.1	27-44-04-01	eClass 9.0	27-44-04-01
eClass 9.1	27-44-04-01		

Anmärkningar

Anmärkningar	• Ytterligare färger på tryckknapparna finns på förfrågan. • Manöverkraft för sliden max. 40 N • Märkström relaterad till märkarea och min. antal poler. • AEH med plastkrage enligt DIN 46228/4 • AEH utan plastkrage enligt DIN 46228/1 • P på ritningen = raster • Märkdata avser respektive byggdel. Luft- och krypsträckor till andra byggdelar skall utformas i enlighet med de relevanta normerna. • För pressning form A för ändhylsor rekommenderas krimpverktyg PZ 6/5 för de största kabelstorlekarna.
IPC-konformitet	Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkända standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Övriga anspråk gällande produkterna kan bedömas på begäran.

Godkännanden

Godkännanden	
ROHS	Uppfyllelse

OMNIMATE Signal – serie LSF
LSF-SMD 3.50/12/180 SN BK RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Downloads

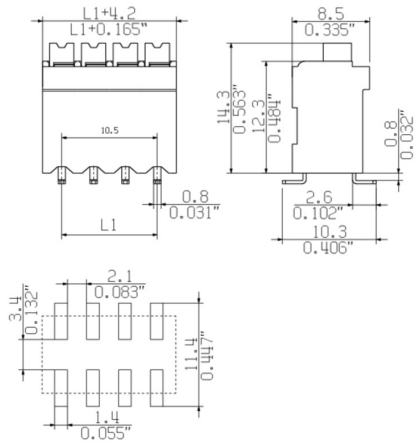
Broschyr/Katalog	FL DRIVES EN PI OMNIMATE LSF SMD EN FL ANALO.SIGN.CONV. EN MB DEVICE MANUF. EN FL DRIVES DE CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN FL BUILDING SAFETY EN FL APPL LED LIGHTING EN FL INDUSTR.CONTROLS EN FL MACHINE SAFETY EN FL HEATING ELECTR EN FL APPL_INVERTER EN FL_BASE_STATION_EN FL ELEVATOR EN FL POWER SUPPLY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	Declaration of the Manufacturer
SMT, white paper	Download Whitepaper
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP

OMNIMATE Signal – serie LSF
LSF-SMD 3.50/12/180 SN BK RL

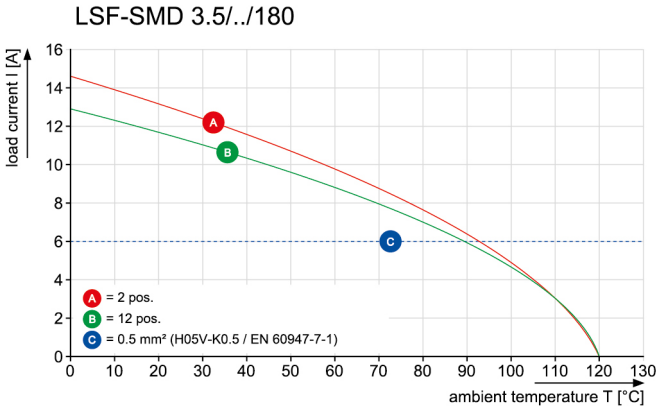
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

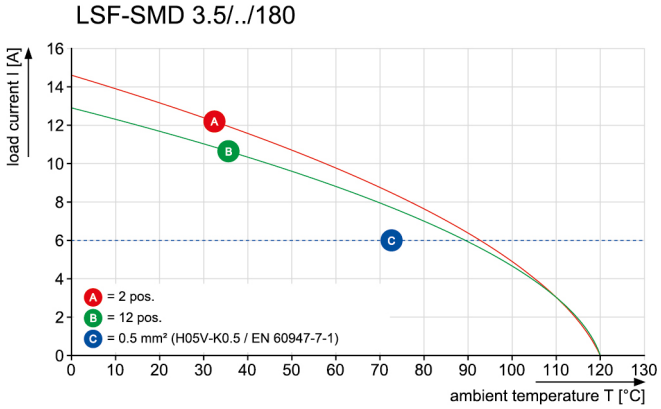
Dimensional drawing



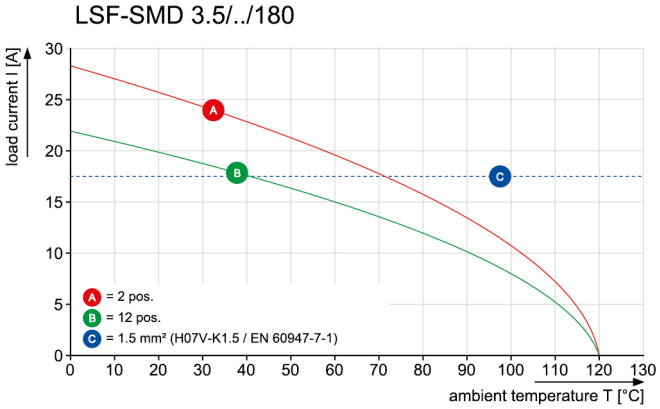
Graph



Graph

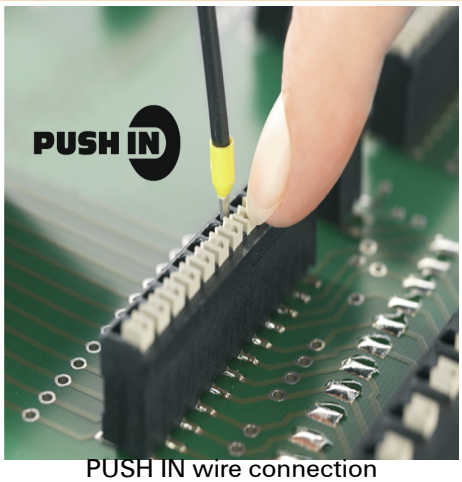


Graph



Stable solder connection

Produktfördel



PUSH IN wire connection

Produktfördel



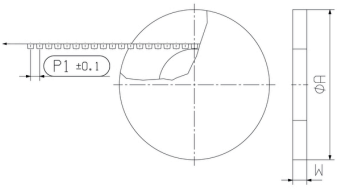
Packaged in tape-on-reel

OMNIMATE Signal – serie LSF
LSF-SMD 3.50/12/180 SN BK RL

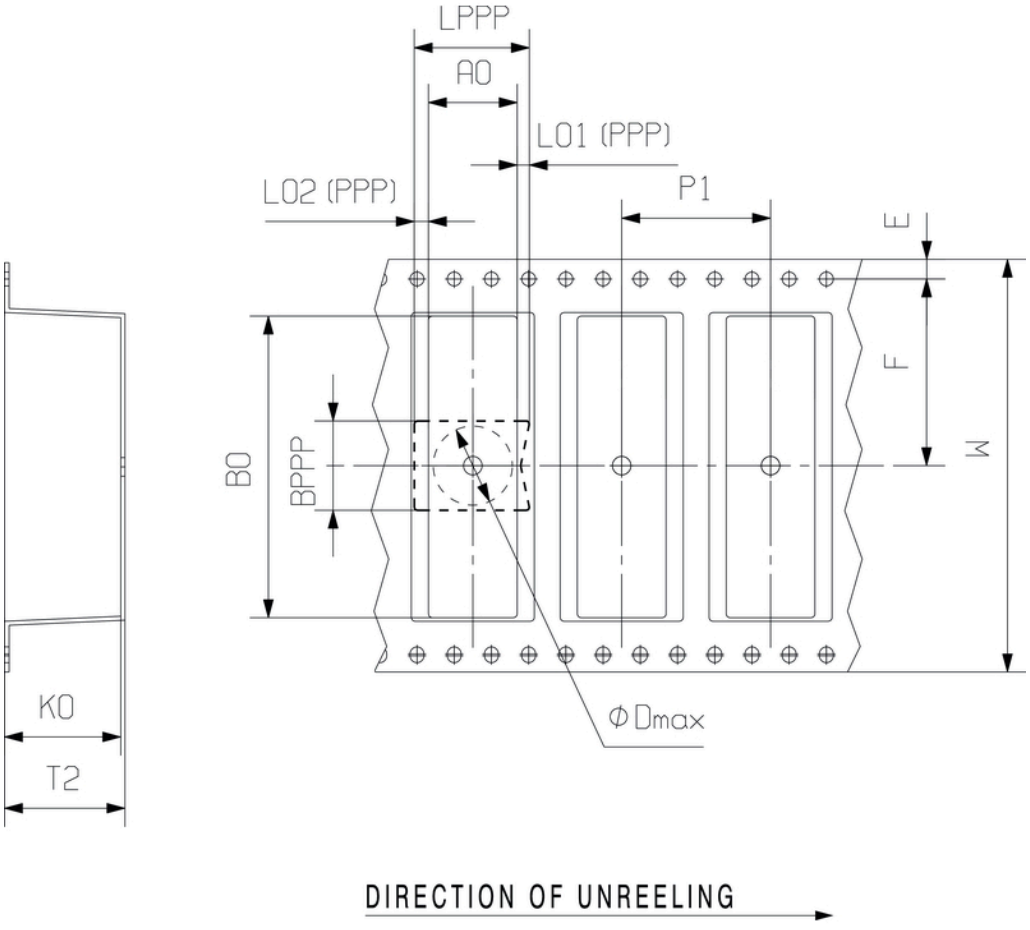
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

Dimensional drawing



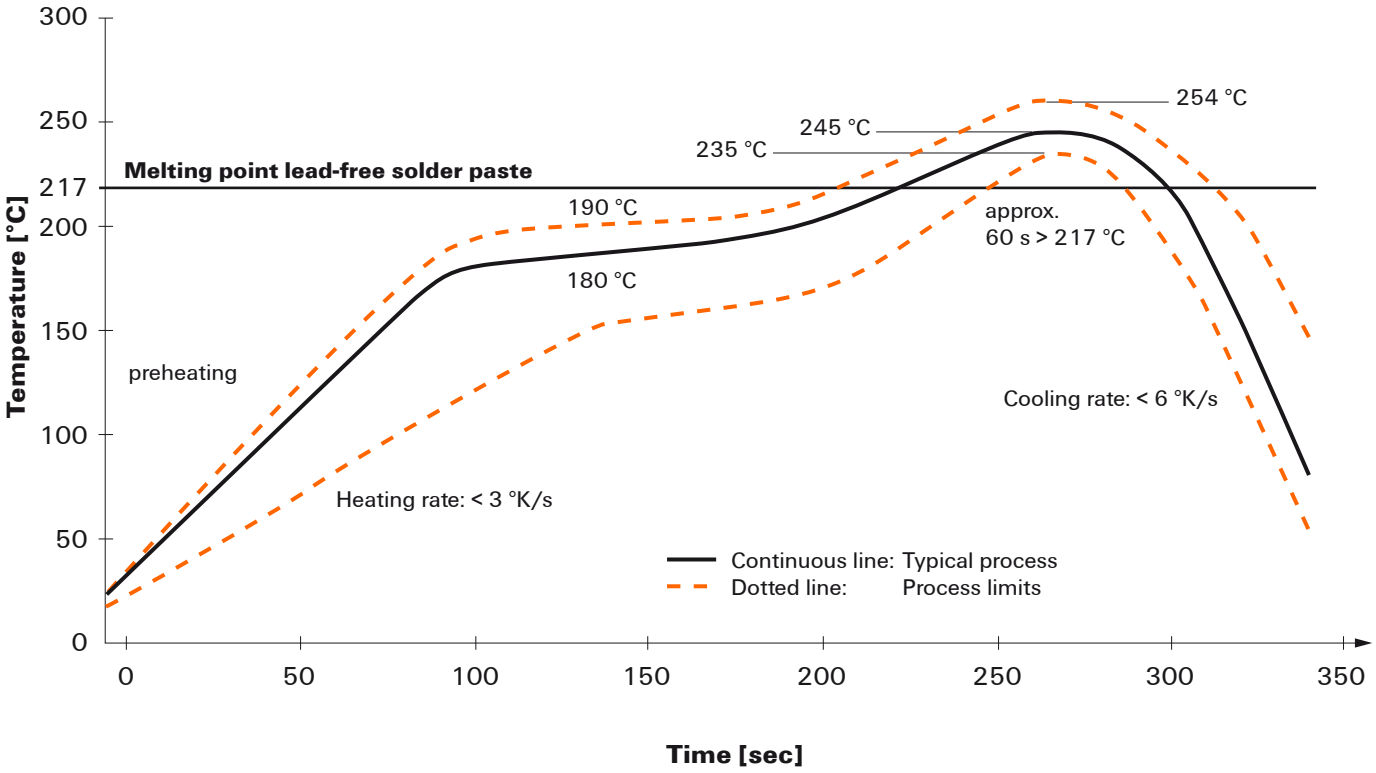
Dimensional drawing



Reflow Solder Profile

Recommended reflow soldering profile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:
- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically ≤ +3K/s. In parallel the solder paste is ‚activated'. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at ≥ -6K/s solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.

We reserve the right to make technical changes.